

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成18年7月13日(2006.7.13)

【公開番号】特開2005-125627(P2005-125627A)

【公開日】平成17年5月19日(2005.5.19)

【年通号数】公開・登録公報2005-019

【出願番号】特願2003-364193(P2003-364193)

【国際特許分類】

B 2 9 C	59/04	(2006.01)
B 0 5 D	3/12	(2006.01)
B 0 5 D	7/04	(2006.01)
G 0 2 B	1/10	(2006.01)
B 2 9 L	7/00	(2006.01)

【F I】

B 2 9 C	59/04	Z
B 0 5 D	3/12	C
B 0 5 D	7/04	
G 0 2 B	1/10	Z
B 2 9 L	7:00	

【手続補正書】

【提出日】平成18年5月29日(2006.5.29)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

少なくとも表面が熱可塑性樹脂層からなり、平滑な表面形状を有する基材の表面に、透明な硬化型樹脂からなり、前記熱可塑性樹脂層の表面よりも表面粗さの粗い、微細な凹凸状の表面形状を有する表面保護層を形成し、硬化させた後、該表面保護層上から熱圧プレス処理を施すことにより、該表面保護層の表面を平滑化させると同時に、該表面保護層と前記熱可塑性樹脂層との界面に、該熱圧プレス処理を施す前の該表面保護層の表面形状をほぼ反転させた微細な凹凸状の界面形状を形成することを特徴とする、表面が平滑な表面保護層の形成方法。

【請求項2】

前記表面保護層の形成前の前記基材の表面粗さ(JIS B 0601(2001))が、算術平均粗さRaが1.0μm以下、最大高さ粗さRzが10.0μm以下であり、前記熱圧プレス処理の前の表面保護層の表面粗さが、算術平均粗さRaが0.5~1.0.0μm、最大高さ粗さRzが2.0~30.0μmであり、前記熱圧プレス処理後の表面保護層の表面粗さが、算術平均粗さRaが1.0μm以下、最大高さ粗さRzが10.0μm以下であることを特徴とする、請求項1に記載の表面が平滑な表面保護層の形成方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 0 9 】

また本発明は、上記方法において、前記表面保護層の形成前の前記基材の表面粗さ（JIS B 0601（2001））が、算術平均粗さRaが $1.0 \mu\text{m}$ 以下、最大高さ粗さRzが $10.0 \mu\text{m}$ 以下であり、前記熱圧プレス処理の前の表面保護層の表面粗さが、算術平均粗さRaが $0.5 \sim 10.0 \mu\text{m}$ 、最大高さ粗さRzが $2.0 \sim 30.0 \mu\text{m}$ であり、前記熱圧プレス処理の後の表面保護層の表面粗さが、算術平均粗さRaが $1.0 \mu\text{m}$ 以下、最大高さ粗さRzが $10.0 \mu\text{m}$ 以下であることを特徴とするものである。